





# 2025年度の業績振り返りと 今後の事業戦略



代表取締役社長

前田和夫

## コア技術の深耕と新領域開拓による持続的成長へ

### 生成AI関連が牽引し、過去最高の売上高に

当期の世界経済は、米国の通商問題による関税政策の不確実性や長期化するウクライナ情勢、緊迫する中東情勢など地政学リスクの高まりにより、先行き不透明感が強まる中で推移しました。わが国においては、雇用・所得環境の改善の動きが続く中、緩やかな回復基調となりました。

このような環境のもと、半導体市場およびエレクトロニクス業界では、引き続き生成AI関連が市場を大きく牽引した一年となりました。当社が強みを持つ半導体パッケージ基板においては、先端領域で大型化・高機能化が進展し、当社製品の需要は旺盛に推移しました。汎用半導体パッケージ基板においては、OSサポート終了による更新需要があったパソコン、高機能スマートフォンの需要などに支えられ、力強さを欠いたものの回復基調で推移しました。自動運転への技術転換が進む車載向けは底堅く推移し、衛星通信向けは増加傾向で推移しました。

これらの影響を受けて主要製品の売上動向が堅調に推移し、当期売上高は過去最高となりました。営業利益面でも薬品生産量の増加や収益性の高い製品需要が堅調で増益となり、当期純利益は為替の影響や「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等」の大規模成長

投資補助金」の収入、前期のグループ再編に伴う税負担からの回復もあって、前期比で大幅に増加しました。

### 主力製品「CZシリーズ」は大幅増

半導体を搭載する半導体パッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、生成AI関連向けの旺盛な需要やパソコン、スマートフォン向けの回復により非常に好調で、データセンターおよび高速通信向け用途が需要を牽引した先端半導体パッケージ基板向けでは、最先端の超粗化タイプCZ-8401が増加。化学密着向上剤「APシリーズ」もAI・高速通信向け需要を背景に順調に需要が拡大しています。

### 「V-Bond・EXEシリーズ」増加、 「SFシリーズ」減少

多層基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」は、車載基板向けや衛星通信基板向けを中心に、TVを主としたディスプレイ搭載のCOF\*製造工程に使用される「EXEシリーズ」は増加しました。一方、ディスプレイ向け選択エッチング剤「SFシリーズ」は、タブレットPC等関連する電子機器の生産動向を受けて減少しました。

## グローバル供給・技術サポート体制の強化

東南アジア市場を担うタイでは、電子基板メーカーの東南アジアへの進出が進み設備投資が活発に行われています。当社はサポート力を一層充実させ供給体制を強化しています。台湾については、先端半導体パッケージ基板の世界的供給拠点であり、同時に情報のハブでもあります。日本の研究開発・マーケティング部隊と連携して、顧客ネットワークの先にある需要の把握に注力していきます。半導体産業の発展が加速する中国では欧米・台湾系企業の動向を注視しつつ、中国系メーカーも多数存在するため、マーケティング情報の収集能力をさらに高めていく考えです。

## 今後の事業戦略と注目する技術領域

引き続き半導体パッケージ基板分野を技術的に深掘りし、需要をしっかりと獲得していくことが基本方針です。そのうえで新たな重点領域への展開を進めています。その一つが「有機インターポザー \*」市場です。従来シリコンインターポザーで行っていた多チップ接続を、コスト低減や設計自由度向上を目的に基板技術で置き換える動きが加速していく見通しです。この市場は今後、当社の技術優位性が発揮できる領域となると考えており、積極的に取り組んでまいります。

また、半導体パッケージ基板の下にあるマザーボード領域も、高速な情報処理が求められる分野で信号周波数の急速な高速化により技術難易度が上がっています。当社のコア技術が活かせる重点ターゲットとして位置づけ、計画的に取り組んでいます。さらに、次世代基板として注目されているガラスコア基板への取り組みも開始しています。市場全体の拡大はまだ先と見ていますが、先進的なお客様と協力して必要な薬品プロセスを提供していく方針です。

## 成長投資と株主還元方針の明確化

成長投資については、北九州市に建設中の工場の完成を最優先に進め、そのうえで研究開発投資を引き続き強化してまいります。研究開発には今後も「連結売上高約10%」を投資していく方針で、将来的な研究開発拠点の拡充も視野に入れ、人財への投資も含めたメリハリのある資金配分を行ってまいります。

株主還元につきましては、「連結配当性向35%以上」かつ「DOE(株主資本配当率)4%以上」とし実施することを基本方針といたします。

## 株主の皆様へのメッセージ

引き続き半導体の後工程、特に電子基板分野を中心に、当社の技術力でしっかり貢献してまいります。技術的な優位性を軸に競争力を発揮し、利益を上げ、次の投資につなげていく。このサイクルを継続してまいります。また、最先端分野だけでなく汎用領域も含めて、半導体がきちんと動くために必要なニーズを支えることが当社の存在意義でもあります。生成AIや自動運転、DXなどの進展に向けた半導体需要を伴うメガトレンドは継続しており、こうした取り組みを続けていくことで持続的成長を図り、株主の皆様のご期待にお応えしてまいりますので、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## 用語解説

### COF(Chip On Film)

フィルム状基板に直接半導体チップを搭載する実装技術

### インターポザー (Interposer)

半導体チップや電子部品を接続するための中間基板。高密度配線や異種チップ間の高信頼接続を実現する重要な役割を担う



詳細はホームページ掲載の決算短信をご覧ください。  
[www.mec-co.com/ir/library/](http://www.mec-co.com/ir/library/)



## 2025年度のポイント

押さえておきたい2025年度のポイントを3ポイントにまとめています。

- 1 AI・メモリー需要拡大で売上高200億円突破
- 2 「CZシリーズ」が大幅伸長
- 3 連結配当性向35%以上かつDOE4%以上へ



## 2025年度の実績

	2024年 12月期	2025年 12月期	増減
	2024年1月1日~ 2024年12月31日	2025年1月1日~ 2025年12月31日	
売上高 (百万円)	18,234	20,947	14.9% 増
営業利益 (百万円)	4,562	5,748	26.0% 増
経常利益 (百万円)	4,682	6,051	29.2% 増
親会社株主に 帰属する当期 純利益 (百万円)	2,291	5,028	119.4% 増
1株当たり 当期純利益 (円)	122.38	272.14	

## 当社の主要薬品を紹介

### 密着向上剤

#### ■ CZシリーズ

半導体パッケージ基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用される薬品  
(最終製品例: データセンター、パソコン、スマートフォン、ロボット等)

#### ■ V-Bondシリーズ

多層基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用される薬品  
(最終製品例: 車、スマートフォン、衛星通信等)

### エッチング剤

#### ■ EXEシリーズ

COF(Chip on Film) 基板向けに、不要な銅を溶かし微細配線を形成する用途で使用される薬品  
(最終製品例: テレビ、パソコンのディスプレイ等)

#### ■ SFシリーズ

銅を選択的に溶かす用途で使用される薬品  
(最終製品例: タブレットPC等)



### 業績推移および製品別・セグメント別販売動向について

#### Q 当期の事業環境と業績について教えてください

#### A 生成AI関連が牽引し、過去最高の売上高に

当社グループの関連市場である電子基板・部品業界は、エレクトロニクス業界の影響を受け、堅調に推移しました。データセンターにおける生成AI関連投資の継続的拡大が市場を牽引し、パソコンやスマートフォン、自動運転への技術転換が進展する車載関連も概ね堅調に推移しました。

このような環境のもと、当社グループは2030年ビジョンの実現に向けた第二期である「Phase 2 中期経営計画(2025~2027)」の達成に向けて「創造と変革」を指針に事業活動に取り組み、高密度電子基板向け製品の開発、販売に注力いたしました。

主要製品の売上動向としましては、半導体を搭載する半導体パッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、主に生成AI関連やパソコン、スマートフォン等に係る需要により好調な結果となりました。多層基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」、ディスプレイ向け「EXEシリーズ」は、前期と概ね同水準となり、ディスプレイ向け「SFシリーズ」は関連する製品の生産動向を受け減少となりました。

その結果、当期の売上高は209億47百万円(前期比14.9%増)、営業利益は57億48百万円(同26.0%増)、売上高営業利益率は27.4%(同2.4ポイント増)、経常利益は60億51百万円(同29.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は50億28百万円(同119.4%増)となりました。

#### Q 製品別の販売状況を教えてください

#### A 主力「CZシリーズ」が好調

「CZシリーズ」の売上高は135億41百万円(前期比19.8%増)、薬品売上高に占める割合は67.0%(同2.3ポイント増)となりました。「EXEシリーズ」は14億34百万円(同4.9%増)、「V-Bondシリーズ」は8億43百万円(同1.1%増)、「SFシリーズ」は4億54百万円(同30.5%減)でした。

#### Q 地域別の販売動向はどうでしたか?

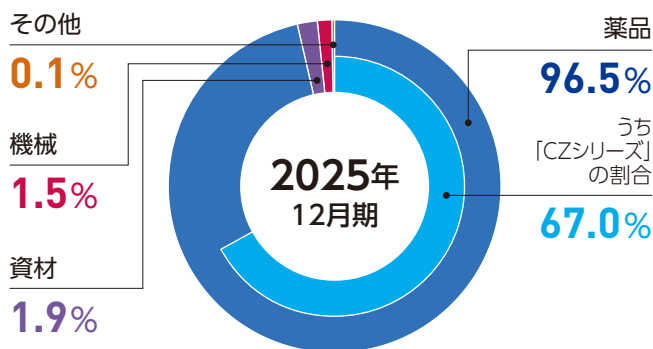
#### A 国内外ともに売上高が増加

地域別売上高(連結)における海外売上高比率は65.1%(前期比3.4ポイント増)となりました。日本では先端半導体パッケージ基板向け製品需要が拡大基調で推移しました。日本代理店経由で

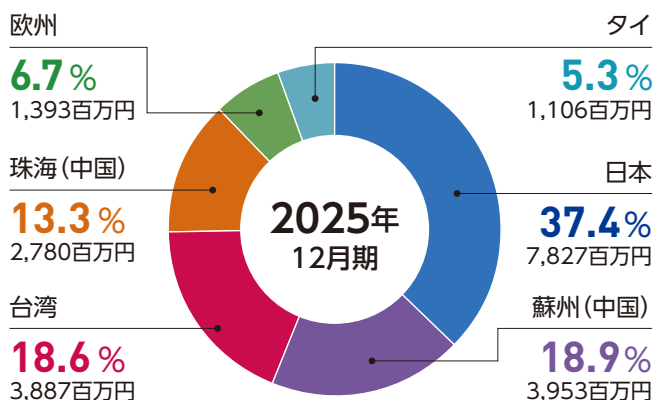
販売している韓国向けにおいては、メモリー向け半導体パッケージ基板の回復基調を受け、関連製品が堅調に推移。売上高は前期比で増加となりました。

台湾では生成AI関連などの先端半導体パッケージ基板、パソコンやスマートフォンなどの汎用半導体パッケージ基板向け製品需要が堅調、珠海(中国)も生成AI関連、スマートフォンやパソコン関連の需要が好調、蘇州(中国)ではスマートフォンやパソコン、ディスプレイ向けの製品需要が堅調で、いずれも売上高は前期比で増加に。欧州では顧客により需要動向に濃淡があるものの、在庫調整局面から脱したことで、資材の一時的な需要により前期比で売上高は増加。タイでは電子基板メーカーの設備投資が活発化する中、車載向け製品は低調でしたが、衛星通信関連の製品が堅調に推移し、売上は前期比で増加しました。

売上高に占める品目別割合 (%)



地域セグメント別売上高比率 (%) / 売上高 (百万円)



\*比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

## 中期経営計画(2025~2027)の修正

当社は、2025年2月に発表した「2030年ビジョン Phase2 中期経営計画(2025~2027)」について、Phase2初年度の進捗を踏まえ、最終年度である2027年12月期の収益性および資本効率に関する定量目標の見直しを行いました。

2030年ビジョン「界面の創出と接合で世界一になる」を掲げ、「創造と変革」を指針とし、2期目にあたるPhase2は、「成長への礎づくり」と位置づけ、「新技術での地位確立」と「既存技術を応用した事業構築」を重点テーマとして取り組んでいます。

Phase2の初年度を終え、当社グループを取り巻く市場環境や高付加価値製品の需要動向を勘案し、定量目標をより明確化いたしました。今後も、将来の成長に向けた投資を継続しながら、資本効率性を意識した事業運営に取り組み、持続的成長と企業価値の最大化を目指してまいります。

より詳しい資料はこちらからご覧いただけます。

[www.mec-co.com/ir/mtp/](http://www.mec-co.com/ir/mtp/)



### Phase2

#### 定量目標

	【当初目標】	【修正目標】
連結売上高	250 億円 コア事業 235億円 応用展開 15億円	250 億円 コア事業 245億円 応用展開 5億円
連結営業利益率	20% 以上	26~30%
ROE	10% 以上	13~16%

#### 定性目標

##### 既存市場における収益性維持・強化

- 顧客との関係性強化
- 超微粗化系密着向上処理のシェア維持
- 無粗化技術(化学密着)領域におけるソリューション確立
- 環境配慮薬品への取り組み

##### 既存技術の応用展開分野における事業構築

##### 新規事業の創出

##### グローバル安定供給体制の確立

##### ESG経営の推進・強化

## 新拠点「北九州工場(仮称)」2026年12月稼働予定

当社は、デジタル社会の進展による電子基板・部品業界の拡大を背景に、今後の当社製品に対する需要増加を見据え、事業継続マネジメント(BCM)の観点から生産体制の強化を進めています。その一環として福岡県北九州市若松区に建設中の新工場は、2026年12月の稼働開始を目指し工事が進んでいます。北九州市での新工場建設については、物流利便性や人財確保の優位性に加え、災害リスク分散等の総合観点で検討し、最適と判断いたしました。

#### 新工場概要

所在地: 福岡県北九州市若松区向洋町10番  
敷地面積: 29,889m<sup>2</sup>  
総投資額: 約47億円(土地取得費含む)  
生産能力: 約30,000t/年(予定)



完成イメージ



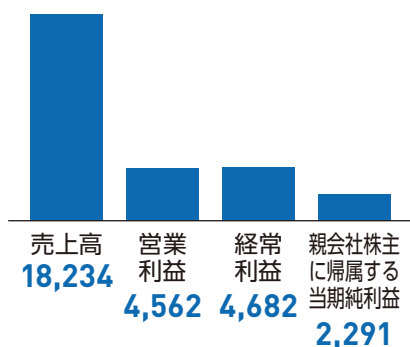
現在の外観(2026年1月現在)



## 連結損益計算書の概要 (百万円)

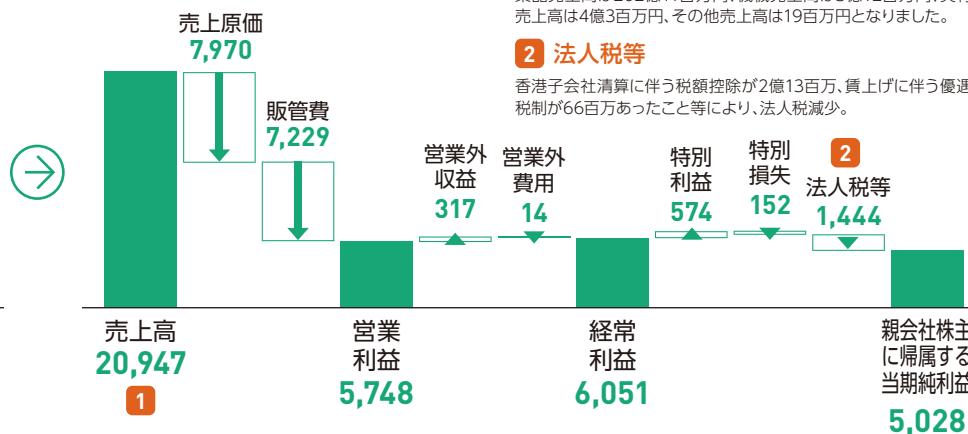
### 2024年12月期

(2024年1月1日～2024年12月31日)



### 2025年12月期

(2025年1月1日～2025年12月31日)



### 1 売上高

薬品売上高は202億11百万円、機械売上高は3億12百万円、資材売上高は4億3百万円、その他売上高は19百万円となりました。

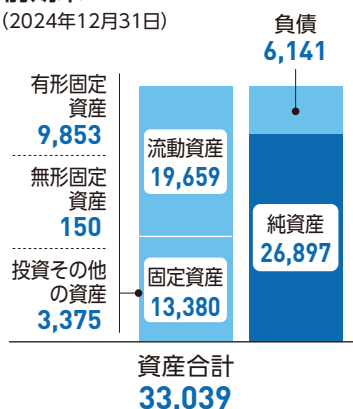
### 2 法人税等

香港子会社清算に伴う税額控除が2億13百万円、真上げに伴う優遇税制が66百万円あったこと等により、法人税減少。

## 連結貸借対照表の概要 (百万円)

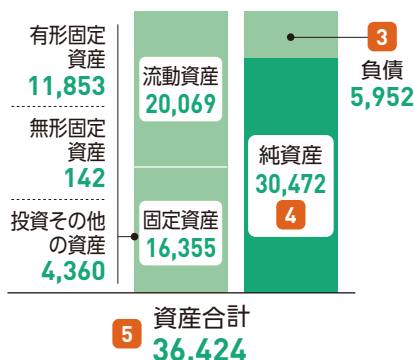
### 前期末

(2024年12月31日)



### 2025年12月期

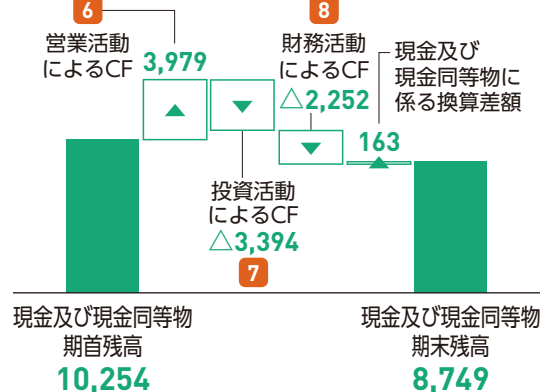
(2025年12月31日)



## 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)

### 2025年12月期

(2025年1月1日～2025年12月31日)



### 3 負債

負債は、電子記録債務の減少等により、1億89百万円減少し、59億52百万円となりました。

### 4 純資産

純資産は、利益剰余金の増加等により、35億74百万円増加し、304億72百万円となりました。

### 5 資産合計

資産は、建設仮勘定の増加等により、33億85百万円増加し、364億24百万円となりました。

### 6 営業活動によるCF

営業活動の結果得られた資金は、39億79百万円。これは主に税金等調整前当期純利益が64億73百万円、減価償却費が8億23百万円、売上債権の増加が12億29百万円および、法人税等の支払額が17億19百万円計上されたこと等によるものです。

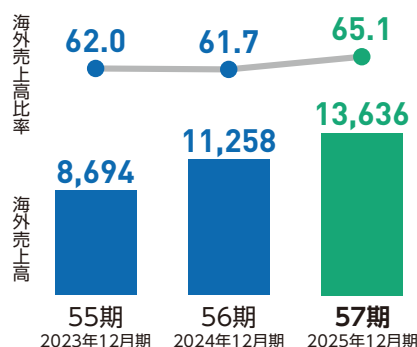
### 7 投資活動によるCF

投資活動の結果使用した資金は、33億94百万円。これは主に有形固定資産の取得による支出が27億35百万円計上されたこと等によるものです。

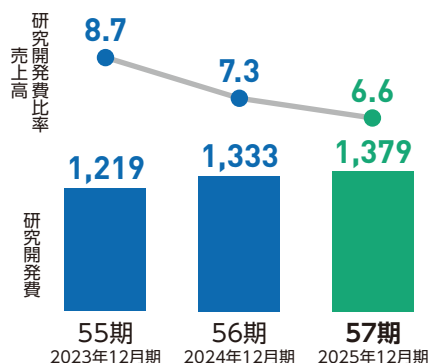
### 8 財務活動によるCF

財務活動の結果使用した資金は、22億52百万円。これは主に自己株式の取得による支出が12億92百万円、配当金の支払が9億35百万円計上されたこと等によるものです。

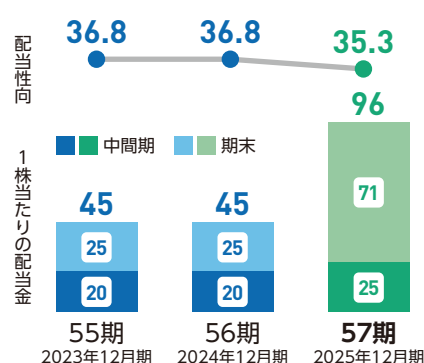
## 海外売上高(百万円)／比率(%)



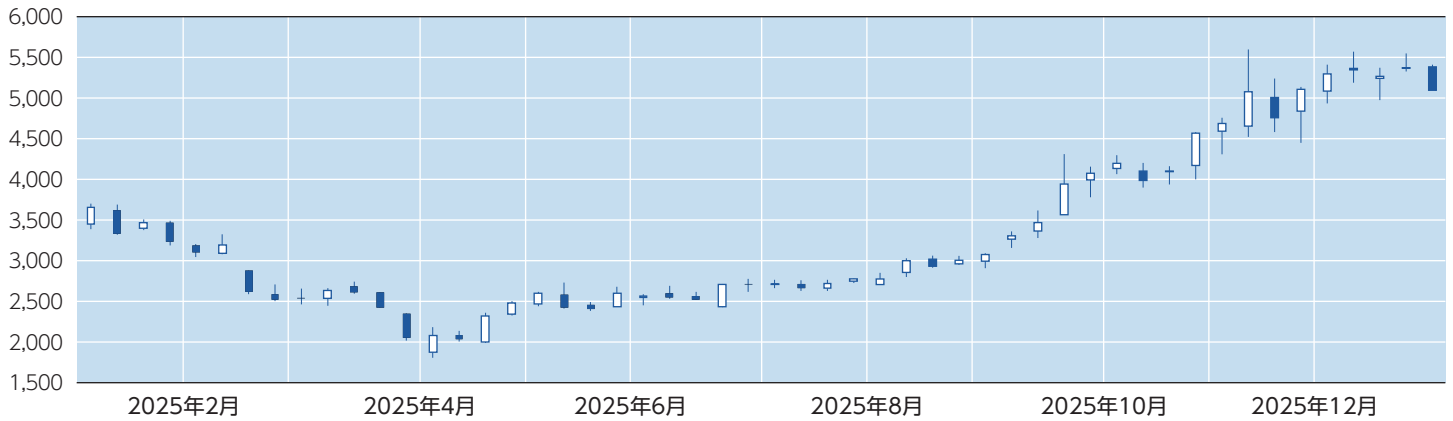
## 研究開発費(百万円)／比率(%)



## 1株当たりの配当金(円)／配当性向(%)







株主メモ

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
期末配当金 受領株主確定日	毎年12月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年6月30日
定時株主総会	毎年3月
単元株式数	100株
株主名簿管理人 および特別口座 の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株式名簿管理人 事務取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先※	TEL. 0120-782-031 (通話料無料) 受付時間 9:00～17:00 (土日休日を除く)
インターネット ホームページURL	www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
上場証券取引所	東京証券取引所プライム市場
証券コード	4971
公告の方法	電子公告により行う。 公告掲載URL www.mec-co.com/ir/denshi/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

1. 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
2. 証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先※までご連絡ください。

ホームページのご紹介

当社のホームページでは企業情報、サステナビリティ情報、製品情報、投資家情報、技術情報等の各種情報を掲載しています。サステナビリティ報告書2025を発行しました。ぜひQRコードよりご覧ください。



本社 / 〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号  
TEL. 06-6401-8160 FAX. 06-6401-8165  
URL [www.mec-co.com/](http://www.mec-co.com/)

株主優待情報

保有株式数	継続保有期間	優待内容
100株以上500株未満	1年以上3年未満	クオ・カード 1,000円分
	3年以上	クオ・カード 2,000円分
500株以上	1年以上3年未満	クオ・カード 2,000円分
	3年以上	クオ・カード 3,000円分

※毎年12月末日を基準日とし、当社株主名簿に記載された100株(1単元)以上保有の株主様のうち、継続して1年以上保有する方といたします。  
 ※継続保有期間が「1年以上3年未満」とは、基準日である12月末および6月末時点の株主名簿において、同一の株主番号で3回以上連続して100株以上の保有が記載または記録されている場合をいいます。  
 ※保有期間が「3年以上」とは、基準日である12月末および6月末時点の株主名簿において同一の株主番号で7回以上連続して100株(1単元)以上の保有が記載または記録されている場合をいいます。  
 ※株主優待の対象となる「保有株式数」とは、「1年以上3年未満」および「3年以上」の保有期間において、基準日を含めた直近3回または7回の株主名簿に記載または記録された保有株式のうち、最も少ない株式数を指します。

ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者の皆様にそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス(ニュースメール配信サービス)を行っています。ご希望の株主様には、こちらのサービスの送信先メールアドレス(携帯電話のメールアドレス不可)を、当社ホームページまたは、RIMSNET (rims.tr.mufg.jp/) から、簡単にご登録いただけます(無料)。

アンケートのお願い

当社では、株主の皆様とのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めていきたいと考えています。つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。※ご提供いただきました情報は、本アンケートの集計の目的以外に使用することはありません。

